日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号 ： PCN#20080818002
2008 年 12 月 12 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 品質保証部
カスタマドキュメント マネージャ 牧 達郎

TI-Tucson製造一部製品 組立/検査サイト変更のご案内

（初版 PCN20080818002 2008 年 8 月 27 日発行）

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐Initial notice (Plan)	■Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐Design	☐Electrical	☐Mechanical
	Wafer Fab	☐Site	☐Process	☐Material
	Wafer Bump	☐Site	☐Process	☐Material
	■Assembly	■Site	☐Process	☐Material
	■Test	■Site	☐Process	
	Others	■Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	TI-Tucson 製造一部製品 組立/検査サイト変更 現行 ：TI-Tucson(USA) 変更後：MMT 社(旧 ALP 社:Thailand) 注)ALP(AlpaTec)社は MMT(Millenium Microtech)社になっています。			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	2009 年 1 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐計画	■終了		
製品表示	☐変更無し	■変更あり		
備考	－			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ) TI-Tucson製造一部製品 組立/検査サイトについて、TI-Tucson製造終了に伴い、TI-Tucsonサイトに替わり MMT社(Millennium Microtech社:旧ALP社(タイ))での製造に移行します。また、出荷梱包部材(梱包箱,テープ&リール,トレイなど)につきましては、認定しましたサイトで現在使用しております部材の使用とさせていただきます。変更品の出荷につきましては本通知日の30日以降を予定いたしております。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差),外観,動作特性,品質,信頼性への影響はありません。

変更内容	現行	変更後
組立/検査サイト	TI-Tucson	MMT社(旧ALP社)

理由：製品供給能力維持確保の為

対象製品リスト

対象製品名 ■: 認定終了品　薄字/右詰:認定作業中				
ADS7800AH	ISO102B	ISO121G	OPA2541BM	OPA541BM
ADS7800BH	ISO106	LOG100JP-2	OPA2541SM	OPA541SM
DAC811AH	ISO106B	MPY100AG	OPA2541SMQ	OPA637SM
DAC811BH	ISO120BG	MPY100BG	OPA404AG	XTR101AG
INA101AG	ISO120G	MPY100CG	OPA404BG	XTR101BG
INA110SG	ISO120SG	MPY100SG	OPA404SG	XTR110AG
ISO102	ISO121BG	OPA2541AM	OPA541AM	XTR110BG

製品表示

今回の変更の伴い出荷ラベルに記載の原産地(ラベル箇所:22L)及び原産国(ラベル箇所:23L)が各々下記の様になります。

	現行	変更後
組立サイト	TI-Tucson	MMT 社
原産地(22L)	BRB	ALP
原産国(23L)	USA	THA

図１出荷ラベルの表示箇所の例

信頼性試験

信頼性試験結果 信頼性試験 – 試料構成詳細			
DEVICE-ID	A	B	C
Qual Device:	ADS7800BH	INA110SG	XTR110BG
Die Size (mils)	C / 136 X 184	T / 89 X 139	78 x 109
Wafer fab Site	TUA	TUA	SFAB/HFAB
Technology	Bipolar	Bipolar	Bipolar
Fab Process	490N	-	630G
Resistor technology	-	-	SiCr
Assembly Site	MMT	MMT	MMT
Package /Code/ Pin	CDIP / JDN / 24	CDIP/ JD/ 16	CDIP/ JD/ 16
Lead Finish	Gold	Gold	Gold

信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails		
		A	B	C
**Steady-state Life Test	125C, 1000 hrs	94/0	119/0	116/0
**Temp Cycle	-65C/150C, 1000 Cyc	77/0	77/0	77/0
Resistance to Solvents	Ink symbol only	22/0	22/0	22/0
Electrical Test	D4 Done post visual insp.	32/0	32/0	32/0
Bond Strength	76 bonds, min. 3 units	76/0	76/0	76/0
Die Shear	-	10/0	10/0	10/0
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Approved		
D4 Mechanical Shock	Condition B	32/0	32/0	32/0
D4 Vibration	Condition A	32/0	32/0	32/0
D4 Constant Acceleration	Condition E	32/0	32/0	32/0
Fine and Gross Seal Leak	D4 Sequence	32/0	32/0	32/0
Visual Inspection	Visual/Methods 1010/1011	32/0	32/0	32/0
**- Samples used to populate these tests must be preconditioned per the appropriate sequence.				

信頼性試験結果 信頼性試験 – 試料構成詳細			
Qual Device:	ISO120G	Assembly Site	MMT
Package /Code/ Pin	CDIP / JVA / 16	Lead Finish	Gold

信頼性試験結果		
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails
**Steady-state Life Test	125C, 1000 Hrs	126/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cyc	77/0
Resistance to Solvents	Ink symbol only	22/0
Electrical Test	D4 Done post visual insp.	32/0
Bond Strength	76 ball bonds, min. 3 units	76/0
Die Shear	-	10/0
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Approved
D4 Mechanical Shock	Condition B	32/0
D4 Vibration	Condition A	32/0
D4 Constant Acceleration	Condition E	32/0
Seal Fine and Gross leak	-	32/0
Visual Inspection	D4 Sequence	32/0
**- Samples used to populate these tests must be preconditioned per the appropriate sequence.		

信頼性試験結果 信頼性試験 – 試料構成詳細			
Qual Device:	XTR101BG	Assembly Site	MMT
Package /Code/ Pin	CDIP / JD / 14	Lead Finish	Gold

信頼性試験結果		
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/Fails
Manufacturability	Per mfg. Site specification	Approved
FTY and Bin Summary	-	Approved